

2024年4月15日

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 プライム市場)
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

L/S=2/2 μ mの描画を実現する DI の開発に成功

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパークイーストタワー9F 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人、以下「当社」）の子会社である、株式会社 LE-TECHNOLOGY（本社：東京都新宿区市谷八幡町2-1 DS 市ヶ谷ビル5F 代表取締役社長（CEO）李 梶、以下 LET）は、L/S=2/2 μ mの高解像な描画を実現する DI(Direct Imaging)の開発に成功、2024年から出荷を開始します。

1. 背景など

5G 等の高速通信技術、生成 AI などの普及による情報量の増大に伴い、情報処理機器には情報伝達の高速化・大容量化・広帯域化が求められています。半導体前工程におけるウエハ上に描画される回路の微細化と半導体チップの大型化を両立が物理的にも経済的にも限界を迎えつつある中で、チップレット等のヘテロロジーニアスパッケージング技術を用いた半導体の高機能化・高集積化・高密度化技術に注目が集まっています。

LET は、業界初の L/S=4/4 μ mの解像度を実現する量産用の DI 露光装置を2023年に出荷、最先端のパッケージ基板を生産するお客様の工場にて本格的な運用が始まっています。また、本装置の実用化の過程で獲得した技術やノウハウを更に発展させ、パッケージ技術の進化に先駆ける L/S=2/2 μ mの描画性能を実現する LAMBDI(読み：ラムディ)の開発に成功、現在、出荷に向けた作業が進められています。

2. 今後について

今後の製品展開につきましては、ガラスインターポーザーを用いた次世代のパッケージ生産に寄与する DI の技術開発をスタート、L/S=1/1 μ m対応する世界最高性能の DI 露光装置として、2025年の出荷を目指します。

当社グループは、アドバンスドパッケージの技術の多様な進化を支える技術の開発を急ぐと同時に、社外のビジネスパートナーの獲得にも取り組み、お客様価値を最大化するソリューションの実現に向けて、引き続き尽力してまいります。

以上